



半导体周报：看好本土功率器件出海



行业近况

上周(9/16-9/23)SW电子指数下降5.2%,SW半导体指数下降6.4%。沪深300指数下降1.9%,恒生科技指数下降7.0%,纳斯达克指数下降5.1%,费城半导体指数下降6.0%。半导体细分板块:SW数字芯片设计指数下降5.7%,SW模拟芯片设计指数下降5.8%,SW集成电路封测指数下降5.2%,SW半导体设备指数下降8.5%,SW半导体材料指数下降5.2%。

评论

半导体制造/设备/材料:上周SW一级行业中电子板块跌幅位列前三,其中半导体设备材料板块跌幅明显,我们认为主要是市场系统性波动导致高估值板块受影响更大。我们认为虽然当前下游消费电子仍面临去库压力,但国产化趋势下,2H2022国内晶圆代工厂产能利用率松动程度有限,我们预计产能利用率将优于行业平均。设备和材料方面,受益于晶圆厂产能扩张,3Q22设备厂商在手订单充足,材料企业需求端保持旺盛,零部件企业多采用寄售模式,下半年设备交付数量通常高于上半年。

功率半导体:上周时代电气公告拟对外投资110亿元用于中低压功率器件建设项目,且获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点。我们认为以时代电气为代表的国内优秀IGBT芯片及模块供应商逐渐具备在新能源车领域走向全球的能力。上周板块标的股价走势明显分化,我们认为市场担心:

1) 时代电气抢占先发优势,其余企业海外业务拓展或承压; 2) 车用IGBT产能紧缺程度逐步缓解,行业竞争或加剧; 3) 车用IGBT“走向海外”边

际变化预期差提前兑现。我们认为本土新能源车主驱半导体供应商订单充足,产能依然受限,并且中长期有望在全球新能源供应链中扮演重要角色。

芯片设计:上周英伟达发布新款汽车芯片 Thor,可实现 2000TOPSAI 算力,目标是实现汽车的中央计算架构,公司预计 2024 年量产。高通在汽车投资者大会上宣布推出 SnapdragonRideFlex 系列,基于 SoC 平台打造自动驾驶芯片,向中央计算架构转型。我们看到集成化的需求将促进驾舱融合的 AI 芯片成为行业主流的长期趋势,但考虑到量产时间、软硬件开发难度、成本等因素,我们认为短期座舱仍以单芯多屏为主要演进方向。

估值与建议

我们维持所覆盖公司盈利预测、评级和目标价不变:半导体设备和材料建议关注北方华创、安集科技、江丰电子;半导体设计建议关注澜起科技;功率半导体建议关注斯达半导。

风险

海外半导体需求不及预期,中美贸易摩擦加剧,个股业绩不达预期。

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_46463

